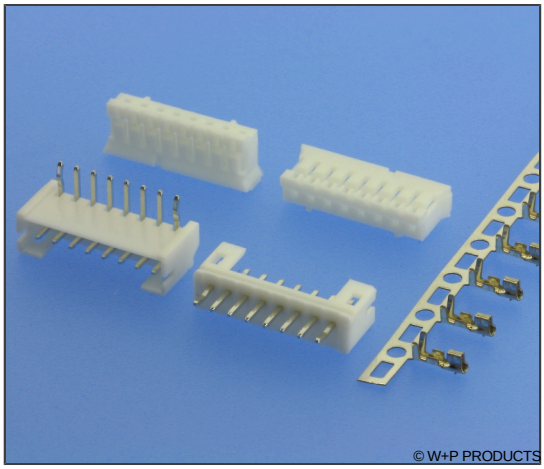
521

Crimp-Rast-Stift-/Buchsenleisten RM 2,00mm, gerade/gewinkelt

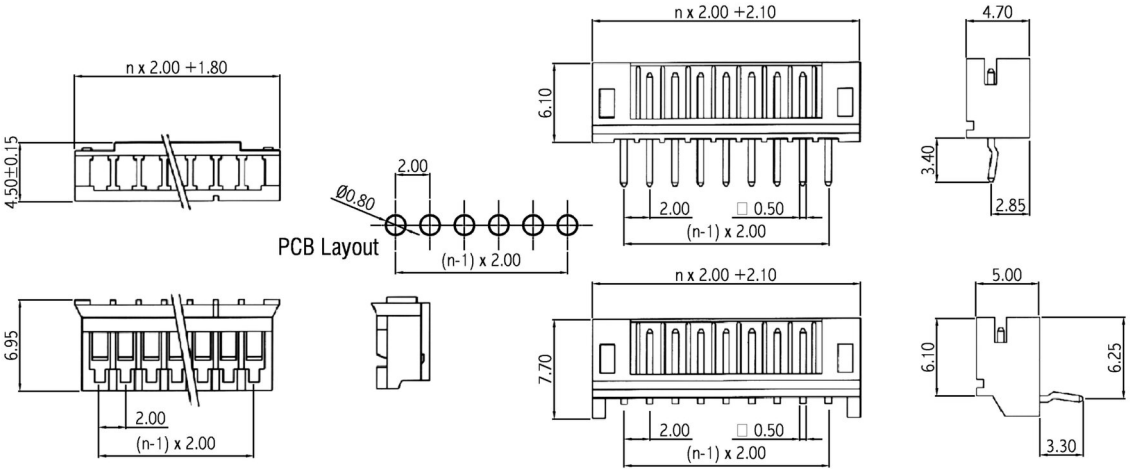
Friction Lock Headers / Crimp Housings, 2.00mm Pitch, Straight/Right-Angled

Technische Daten / *Technical Data*

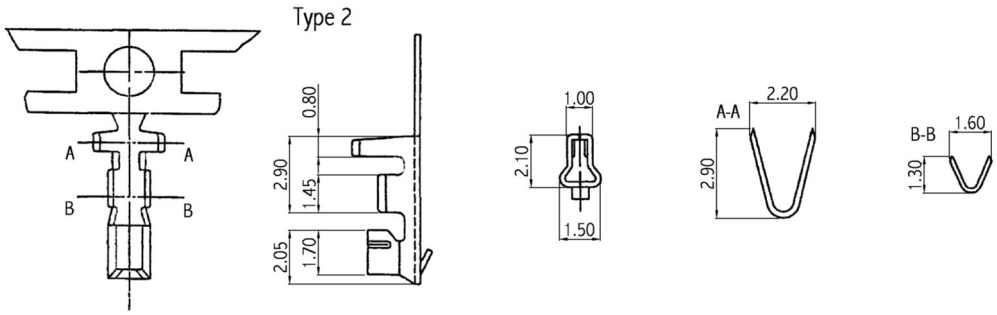
Isolierkörper	Thermoplast, nach UL94 V-0
Insulator	*Thermoplastic, rated UL94 V-0*
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,50mm, Kupferlegierung
Contact Material	*Square pin 0.50mm, copper alloy*
Aderquerschnitt	AWG 30 ~ 24
Wire Gauge	*AWG 30 ~ 24*
Durchgangswiderstand	< 20 mΩ
Contact Resistance	*< 20 mΩ*
Isolationswiderstand	> 1000 MΩ
Insulation Resistance	*> 1000 MΩ*
Spannungsfestigkeit	800 V AC
Withstanding Voltage	*800 V AC*
Nennspannung	100 V AC
Voltage Rating	*100 V AC*
Nennstrom	1 A
Current Rating	*1 A*
Temperaturbereich	-25 °C ... +85 °C
Temperature Range	*-25 °C ... +85 °C*
Verarbeitung	Wellenlötverfahren
Processing	*Wave soldering*



Buchsengehäuse passt auch zur Serie:
Housing mates also with Series:
5210



Series	***Contacts****	***Type****	***Plating***
521	**12**	**3**	**50**
	02-16	**1** Buchsengehäuse *Housing* **3** Stiftleiste gerade *Straight pin header* **4** Stiftleiste gewinkelt *Right-angled pin header*	**50** Verzinnt (für Gehäuse nicht erforderlich) *Tin plated (not used for housings)* **XX** (ohne Plating für Gehäuse) *(without plating, for housings)*



Series	***Contacts***	***Type***	***Plating***
521	**01**	**2**	**50**
		2 Buchsenkontakte AWG 24-30 *Crimp Terminals AWG 24-30*	**50** Verzinnt *Tin plated*

* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
** This is an **order example** -*
please replace by your specifications.

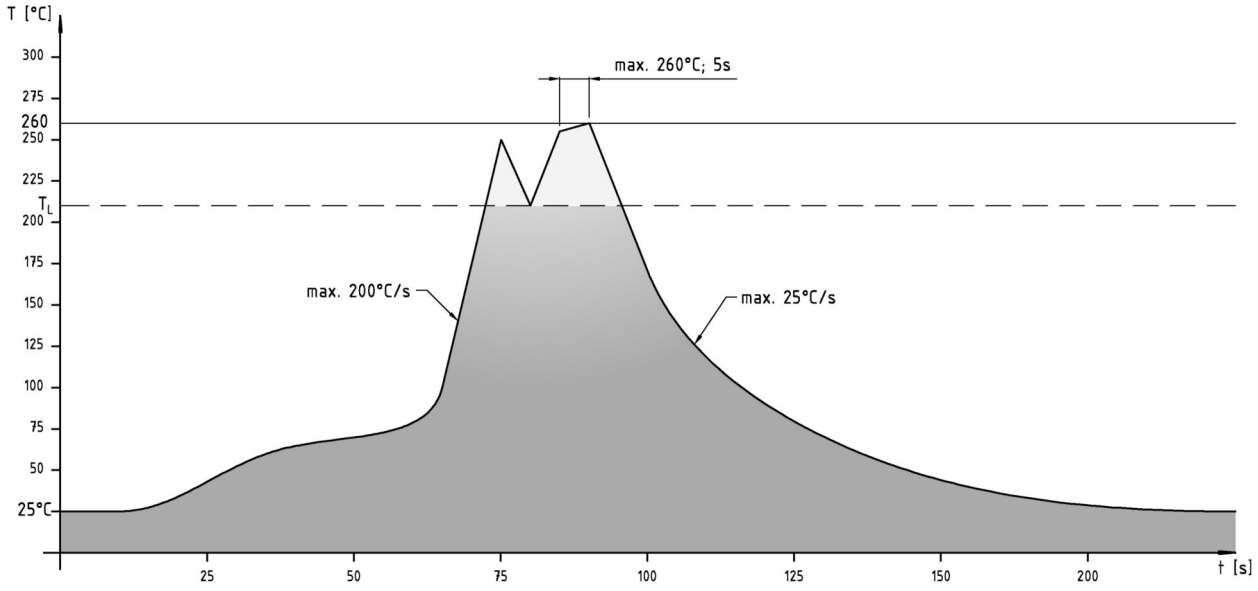
Downloaded from Arrow.com.

Informationen zum Wellen-Lötverfahren
Wave Soldering Information

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Empfohlenes Wellenlötprofil:



Downloaded from Arrow.com.